

SDI系列

晶圆宏观缺陷检测设备

Wafer Macro-Defect Inspection System



应用范围 Application Scope

晶圆类型

切割片、研磨片、抛光片等透光性材料

晶圆尺寸

兼容4, 6, 8, 12英寸及其它非标尺寸

设备特点及优势 Product Introduction

超快检测

≥75 WPH @ 6", 主要用于工艺过程检测

深度学习

易于导入新缺陷, 具备高检出率、高正检率等优势

多种扩展

支持厚度、倒角面幅, 以及3D轮廓量测表征等功能

替代目检

彩色高清成像, 检测效率高, 完美替代人工目检

中电科风华信息装备股份有限公司

网 址: <http://www.zdkfh-ie.com/>

电 话: 18636141900

邮 箱: wangze@zdkfh-ie.com

太原基地: 山西转型综合改革示范区潇河产业园宏业东路11号

上海基地: 上海市闵行区浦江镇江月路999号21号楼



公众号



视频号

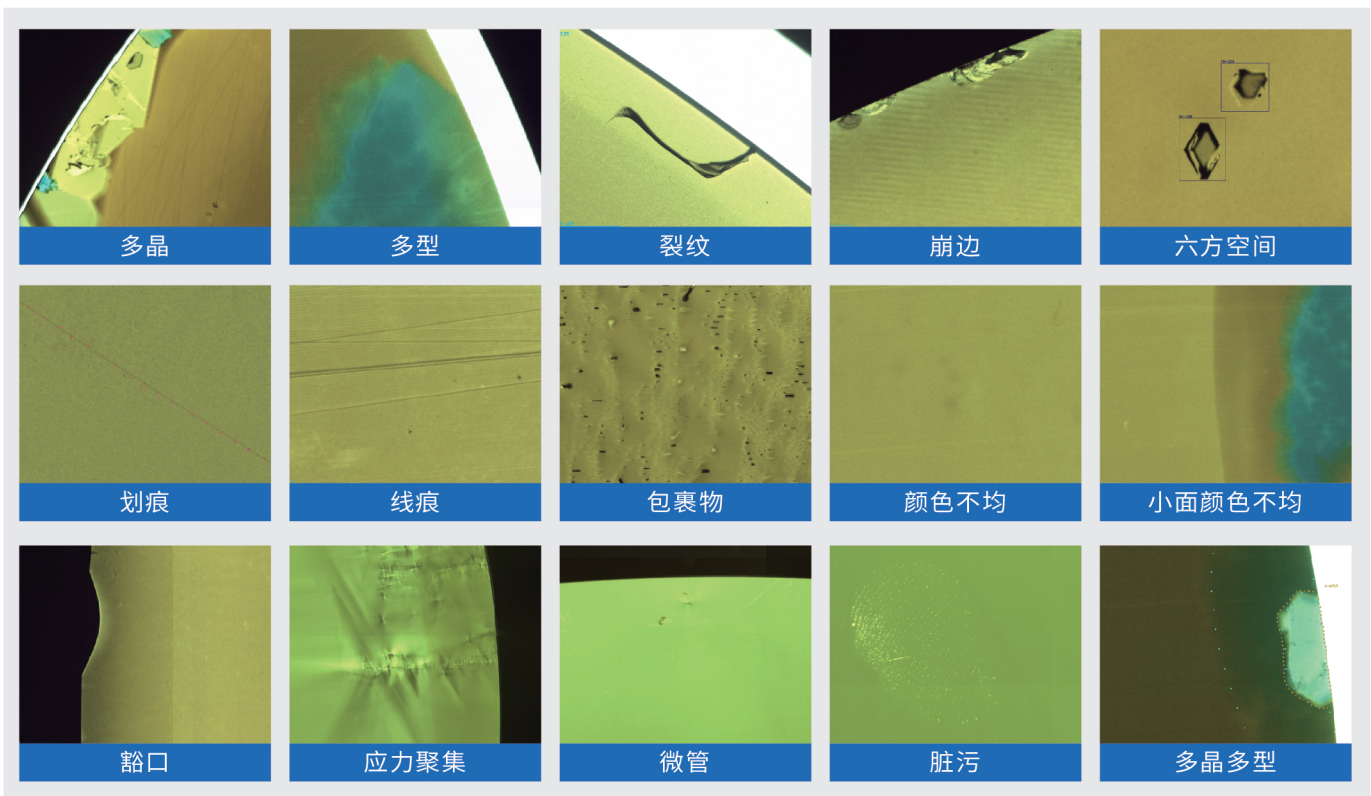
软件算法 Software Algorithm

- ◆ 深度学习结合传统图像的自动检测算法
- ◆ 支持再分析, 缺陷判级分规
- ◆ 支持晶圆判级和自动分拣功能
- ◆ 定义致命缺陷并生成良率分布图
- ◆ 支持Notch、平边以及晶圆直径参数测量
- ◆ 持SECS/GEM协议, 设备与MES系统交互

性能参数 Performance Parameters

技术参数	性能指标
Inspection Channels 检测通道	彩色明场
Throughput 检测通量	≥75 WPH (6"), ≥55 WPH (8")
Imaging Accuracy 成像精度	3 μm
Repeatability 重复性	≥99%
Thickness 检测厚度	≤2.5 mm

检测图例 Inspected Defects



中电科风华信息装备股份有限公司

网 址: <http://www.zdkfh-ie.com/>

电 话: 18636141900

邮 箱: wangze@zdkfh-ie.com

太原基地: 山西转型综合改革示范区潇河产业园宏业东路11号

上海基地: 上海市闵行区浦江镇江月路999号21号楼



公众号



视频号